

股票代號:4989



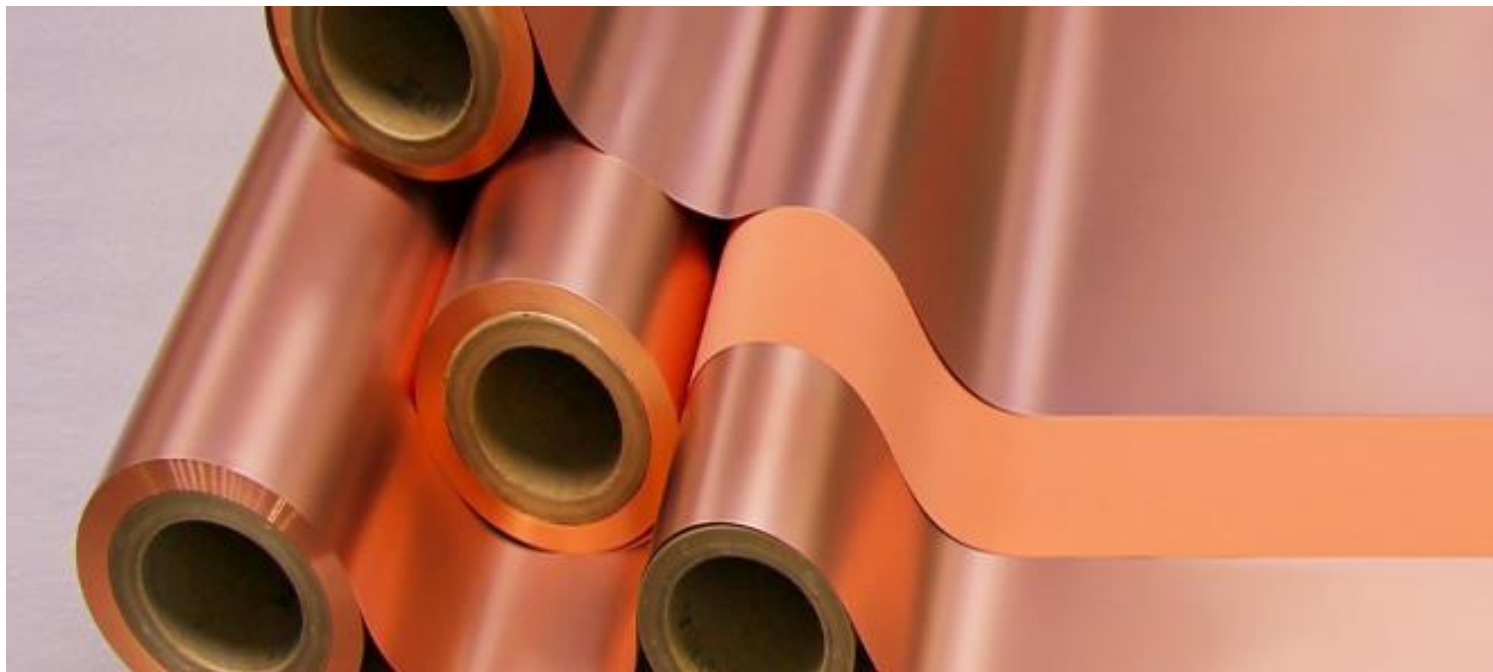
李長榮科技股份有限公司  
LCY TECHNOLOGY CORP.

公司簡介

報告人：陳銘樹總經理

# 簡報內容

1. 公司簡介
2. 經營理念與實績
3. 產品及市場
4. 研發技術能力
5. 未來展望

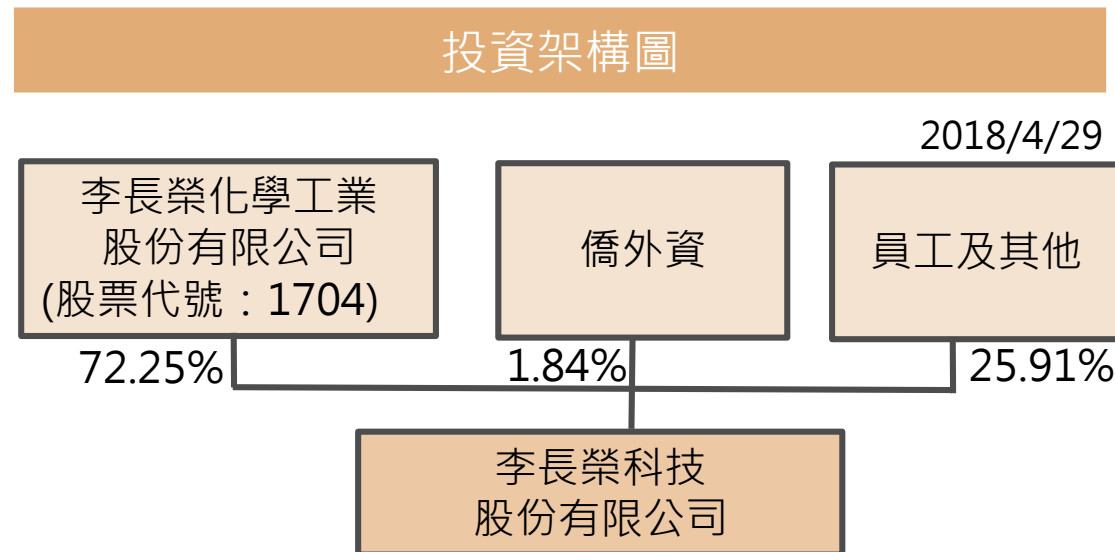


# 基本資料

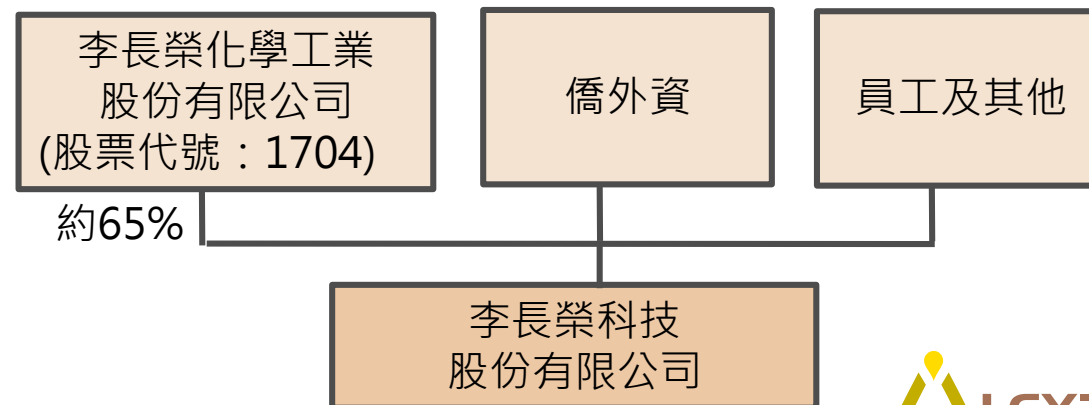
## 公司基本資料

公司名稱	李長榮科技股份有限公司
設立時間	1997年1月
員工人數	214人 (2018年3月31日)
實收資本額	新台幣14億元
主要產品 業務範圍	電解銅箔之設計、製造及銷售
服務據點	台北總公司：台北市松山區八德路四段83號5樓 高雄工廠：高雄市小港區中林路3-1號
簽證會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 劉建良會計師、王儀雯會計師
輔導券商	元大證券股份有限公司

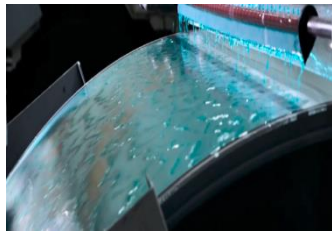
## 投資架構圖



## 上市掛牌後



# 沿革



- 2018
  - 2月/增建ED#30動工，預計投入高階產品(雙面亮及低粗糙度)製程
  - 7月/TS-16949 2016版及 ISO-9001 2015版認證作業進行中，預計2018年7月通過
- 2017
  - 6月/核准成為公開發行公司 / 興櫃市場登錄掛牌
  - 3月/取得 ISO-14001 2015版環境管理系統認證 並 獲頒 15年環境永續獎
- 2015
  - 7月/取得TS-16949 2009版汽車產品品質管理系統認證
  - 2月/資本額為1,400,000仟元
- 2013
  - 9月/取得 ISO-50001 2011版能源管理系統認證
- 2012
  - 11月/響應太陽能政策，屋頂太陽能電板完工啟用
- 2007
  - 10月/銅箔工廠擴建完工量產
  - 9月/銅箔工廠擴建動工
  - 5月/自動倉儲完工
- 2006
  - 7月/產品全面符合歐盟RoHS要求
- 2005
  - 6月/生箔機全面更換無鉛鈦陽極(titanium DSA)
  - 6月/產品條碼建置完成 (QR Code)，且按箔厚給予顏色辨識
- 2000
  - 6月/銅箔工廠完工試車
- 1998
  - 8月/銅箔工廠破土興建
- 1997
  - 1月/李長榮科技股份有限公司成立，資本額200,000仟元



# 經營團隊

董事長 兼 執行長  
王守仁

- 學歷：東海大學化學系學士
- 經歷：李長榮科技(股)公司總經理  
李長榮化學工業(股)公司甲醇溶劑事業處副總經理、橡膠事業處處長
- 產業年資：37年



總經理 暨 發言人  
陳銘樹

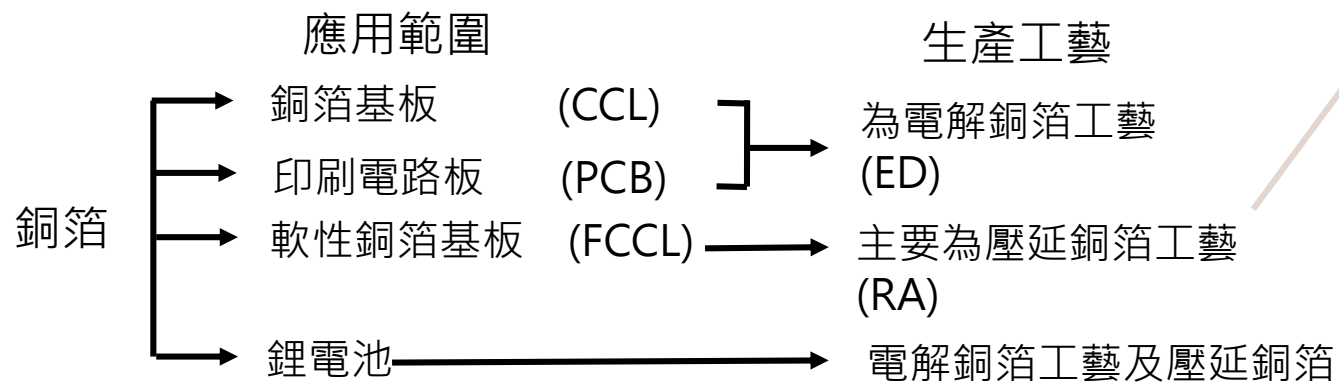
- 學歷：東吳大學國際貿易系學士
- 經歷：李長榮科技(股)公司副總經理、業務部協理  
李長榮化學工業(股)公司發言人、經營企劃室經理、外銷業務部經理
- 產業年資：36年



# 經營團隊

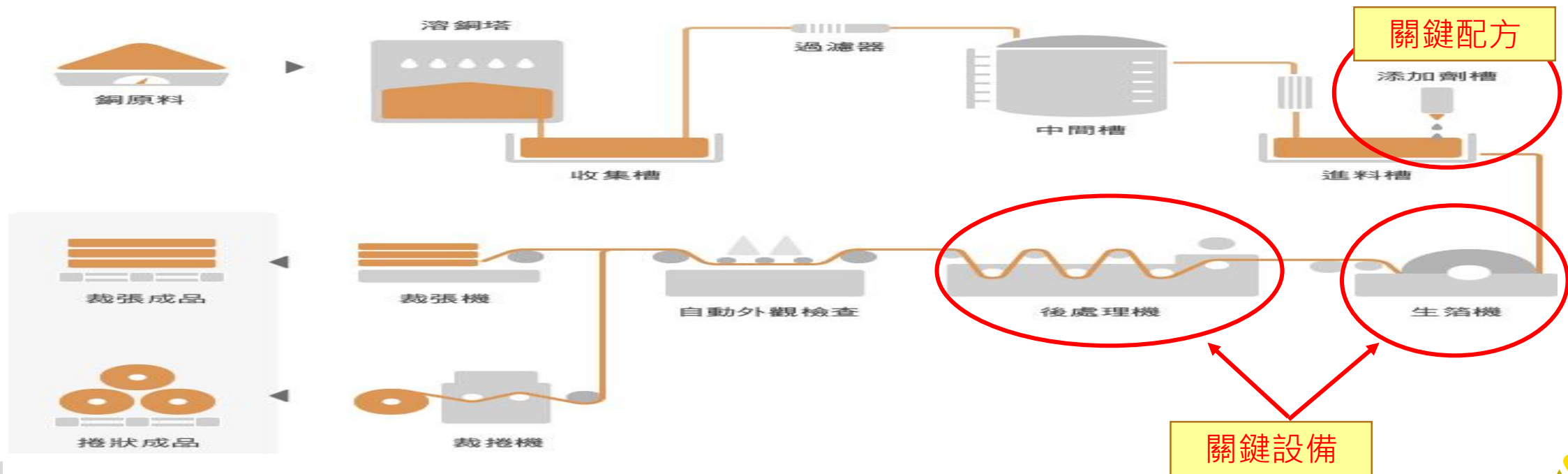
職稱	姓名	學歷	經歷	產業年資
廠長 兼 研發長	徐繼文	中正理工學院 應用化學所碩士	李長榮科技(股)公司銅箔廠副廠長	18
稽核主管	林世峰	淡江大學 企業管理系學士	李長榮化學工業(股)公司採購運籌處經理 李長榮化學工業(股)公司稽核經理	22
財會主管 暨 代理發言人	蔡孟修	東華大學 會計學系學士	李長榮化學工業(股)公司經營企劃室 鎮江李長榮綜合石化工業(股)公司財會負責人 李長榮化學工業(股)公司財務部	13

# 產業狀況



- (1) 關鍵技術掌握於少數廠商
- (2) 耐彎折
- (3) 價格及供應量掌握度低

電解銅箔  
成為主流工藝



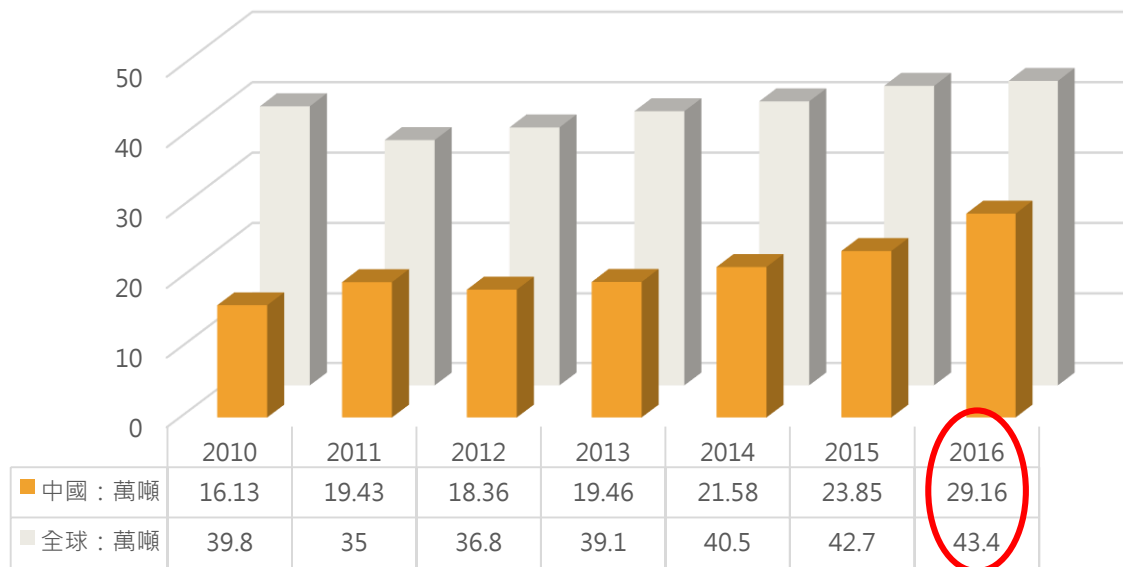
# 產業關連圖



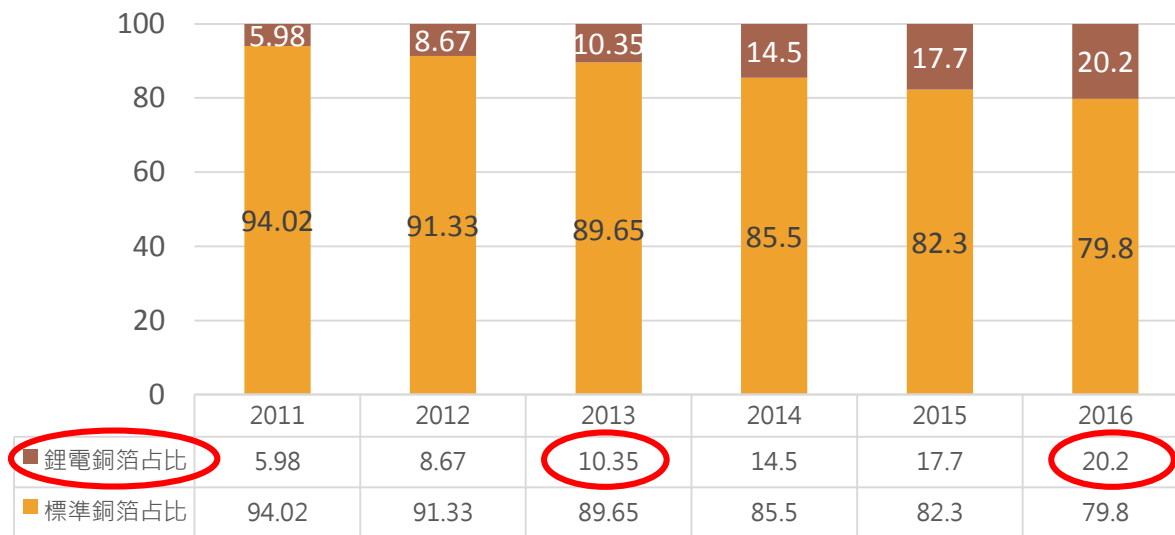


# 市場狀況

全球電解銅箔產量



箔種產量比率



資料來源：中國產業信息網

中國是全球電解銅箔生產重鎮，2016年度產量約占全球市場7成

2018年全球銅箔產能預期可達88萬噸，而中國產能可望達53.4萬噸，占比逾6成  
(中電協銅箔分會)

環保意識抬頭，新能源車成為各國推行重點，鋰電銅箔產量占比大幅提升，2013年只占10.35%，增加到2016年的20.2%

(中國化學與物理電源行業協會)

據預測，2018年鋰電銅箔的供應量為14.6萬噸，需求為16.1萬噸，鋰電池銅箔仍有缺口

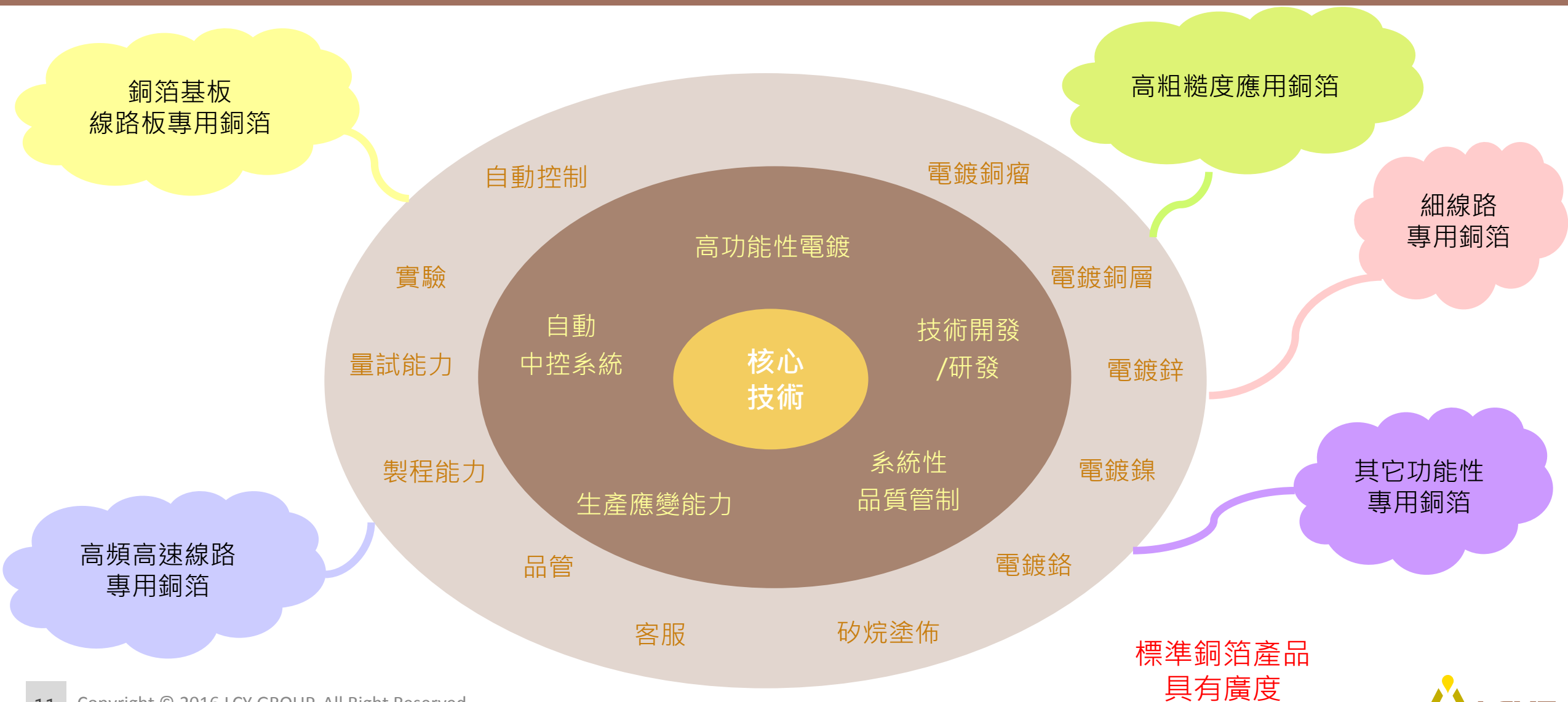
標準銅箔(電子電路銅箔)  
供給缺口

- (1)銅箔產銷品種結構產生變化
- (2)新增產能及產量多投入鋰電銅箔的產製

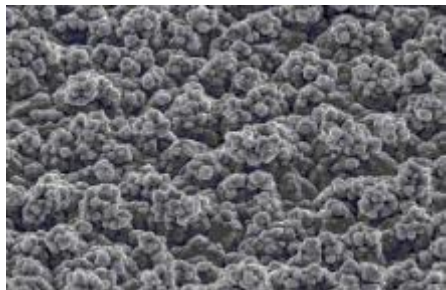
# 經營理念



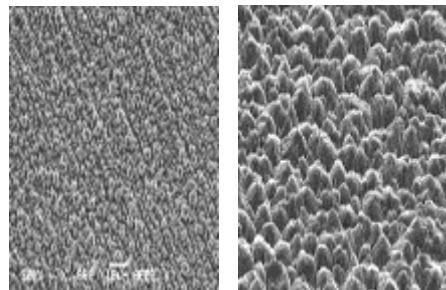
# 核心技術



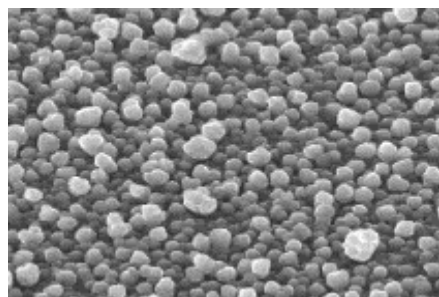
# 主要產品



Hoz 毛面



膠片結合面 光阻結合面



膠片結合面

## • PK-HTE-LP3

主要特色	產品應用
符合IPC-4562A Grade 3之毛面瘤化處理箔 毛面經粉紅色抗熱層處理	可用於一般Tg、Hi-Tg、無鹵基板等基材，單面、雙面、多層板均可用

## • PK-HTE-RTF

主要特色	產品應用
符合IPC-4562A Grade 3之反轉瘤化處理箔 均一瘤化鍍層處理，膠片結合粗糙度較一般箔低	高頻產品、內層薄板

## • BR-DSS-LX series

主要特色	產品應用
極低粗糙度的紅棕色箔 均一的次微瘤化鍍層處理	高頻產品、極細線路板

# 研發技術能力暨近年開發成功產品

## • 研發團隊學歷及年資

研發團隊			年資
研發長	徐繼文	中正理工大學 應化所碩士	18
研發處長	詹炳東	勤益工專 化工科	20
研發經理	郭中全	國立清華大學 化工系	21
研發工程師	黃冠銘	高雄應用科技大學 化工系	19
研發工程師	龔紋毅	台灣科技大學 高分子科學系	8
研發工程師	黃宏銘	正修科技大學 化工系	7
研發工程師	蔡鴻隆	大仁科技大學 環境工程衛生系	6

## • 近年開發成功產品

研發成果			說明
2014	超低粗度(Rz<3.5um)	產業趨勢	針對未來高頻及細線化用途開發
2015	極低粗度(Rz<2.0um)	產業趨勢	前端由工研院技術授權，針對高頻、細線化之用途開發
	7um薄銅箔開發	產業趨勢	配合高階手機開發新製程使用
2016	厚銅箔粗糙度降低	客製化需求	配合客戶需求，提高線路完整性
	極低粗度(Rz<1.5um)	產業趨勢	前端由工研院技術授權，針對高頻、細線化用途開發，主要用於高頻基板用箔
	晶片卡銅箔	客製化需求	新客戶需求
2017	鋅鎳分鍍配方	製程改善	新製程技術，供高頻銅箔開發使用
	極低粗度(Rz<2.0um)	產業趨勢	針對未來高頻及細線化用途開發
	高玻璃轉變溫度膠片 拉力提升	產業趨勢	針對特定客戶產品開發
	低粗糙度反轉箔	產業趨勢	低訊號損失膠片用途開發，供基地台用箔使用

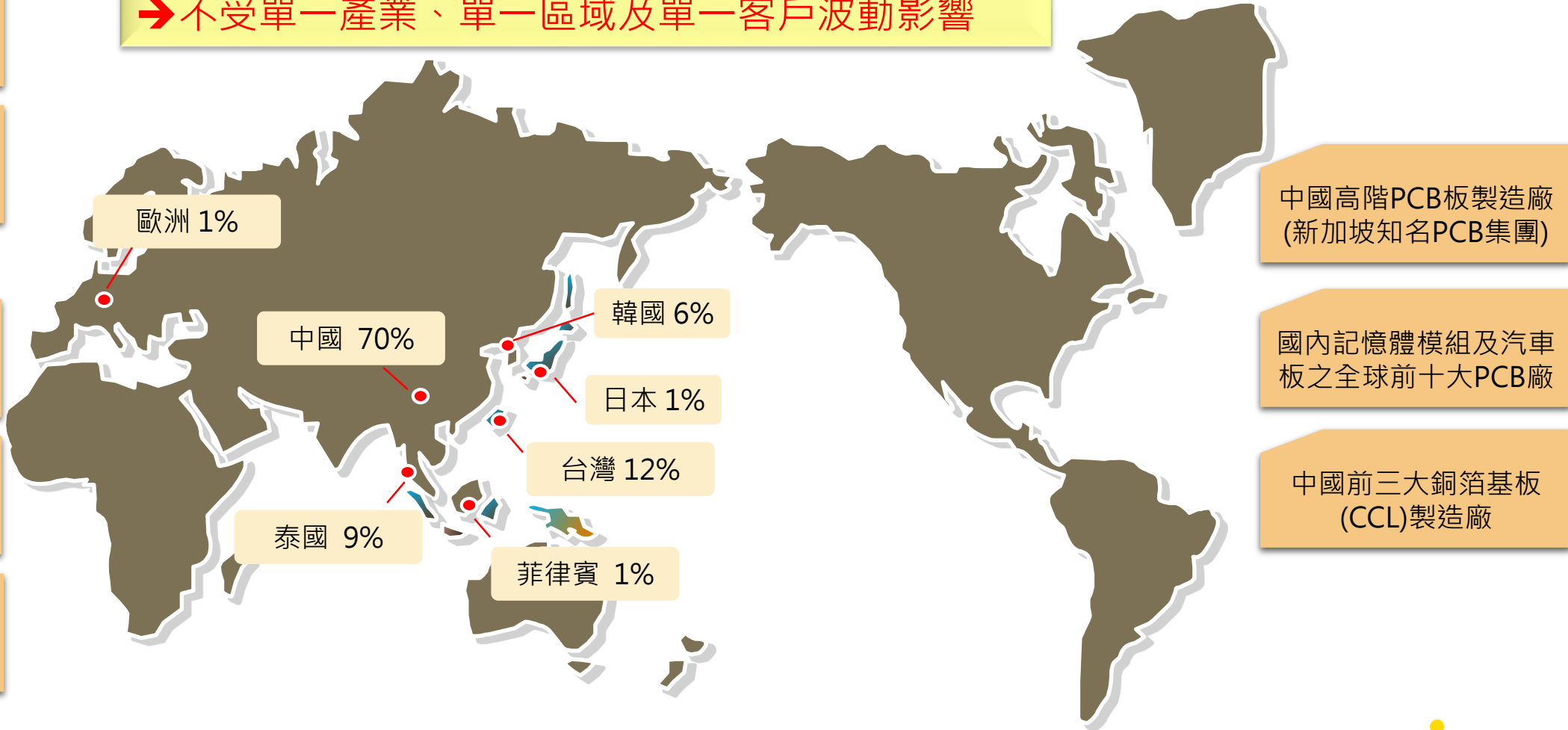
# 研究開發計畫



開發項目			目標進度
BR-DSS-LLX	Rz < 3.5um	厚度35um	<ul style="list-style-type: none"> <li>特殊板卡用箔，主要客戶為歐洲晶片卡大廠</li> <li>已完成開發，進入放量驗證階段</li> </ul>
BR-HTE-2RT	Rz < 2um	厚度為 H 及 1 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>降低成本及訊號損失，供伺服器及雷達使用，預計2018年底完成開發</li> </ul>
BR-DSS-2LX	Rz < 2um HVLP	厚度 ≤ 9um	<ul style="list-style-type: none"> <li>細線路製作，以用於高端智慧型手機，預計2018年底完成開發</li> </ul>
		厚度為 H 及 1 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>降低訊號損失，搶攻高端銅箔市場，預計2020年完成開發</li> </ul>

# 業務版圖

產品組合多樣、銷售區域分散、目標客戶多元  
→ 不受單一產業、單一區域及單一客戶波動影響



美系智慧型手機板廠  
台灣高密度電路板廠

韓系智慧型手機板  
製造廠

全球前三大  
PCB汽車板廠

泰國第一大  
PCB汽車板廠

先進駕駛輔助系統之  
日本汽車板大廠

中國高階PCB板製造廠  
(新加坡知名PCB集團)

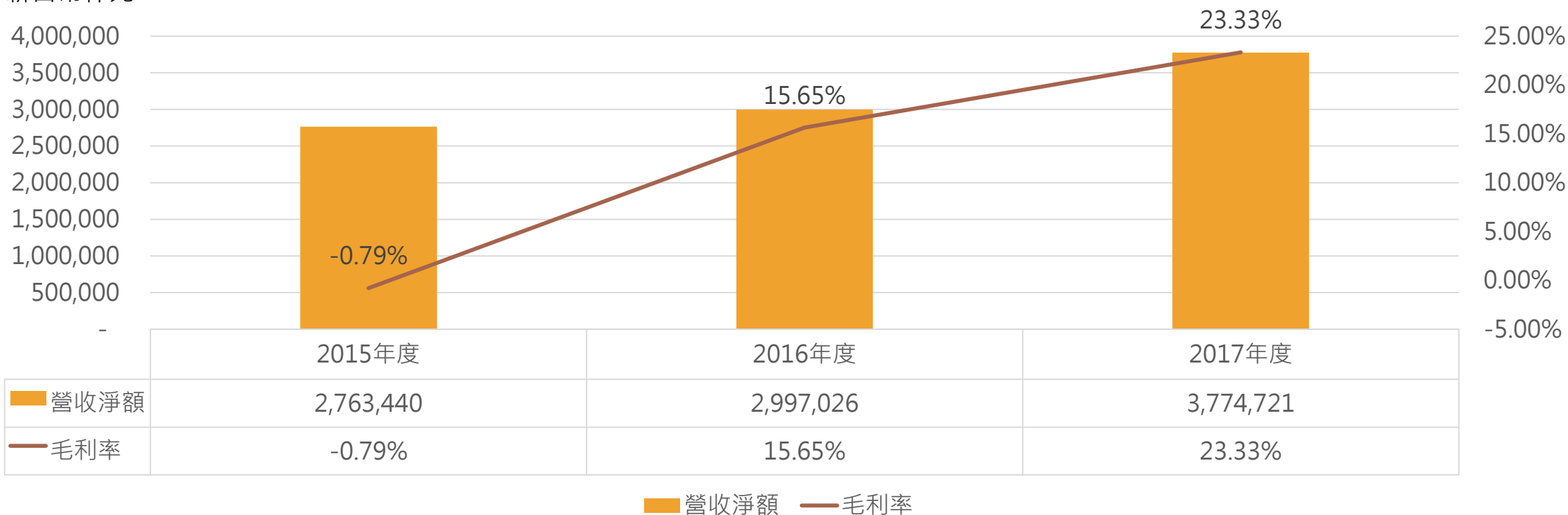
國內記憶體模組及汽車  
板之全球前十大PCB廠

中國前三大銅箔基板  
(CCL)製造廠

# 經營實績

單位：新台幣仟元

營收淨額與毛利率

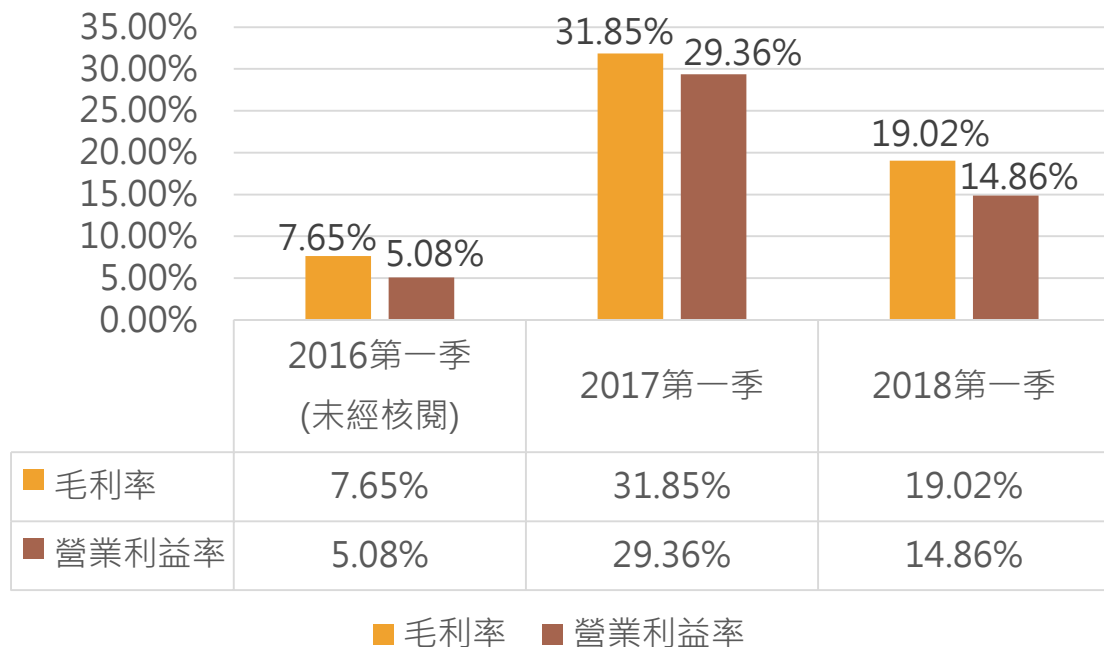


- 人員流動率低專注本業經營著重經驗傳承降低學習成本
- 2016年標箔需求提高，加上開發客戶、產銷配合及對成本控管得宜，轉虧為盈
- 2017年標箔供需穩定，維持客製化商業模式，配合終端產品之運用，深耕薄、厚銅之應用市場



# 經營實績

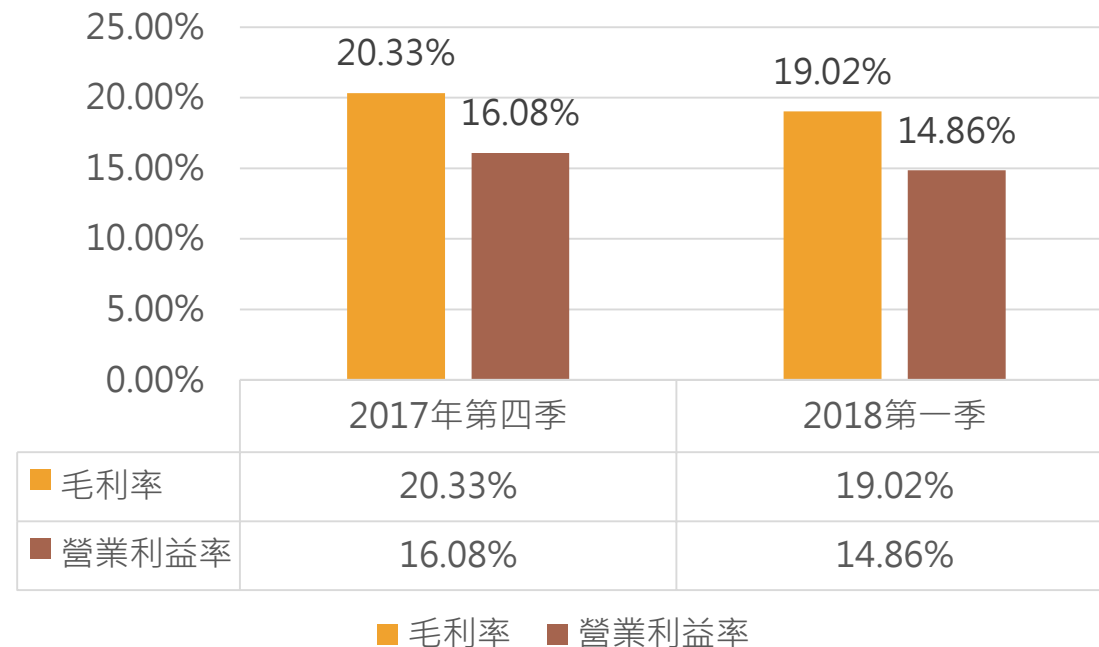
第一季同期比較



- 2016年下半年能源車政策及補貼效應逐漸發酵，對銅箔的需求大幅提高，市場供需失衡

- 本公司全產全銷，2017年初受惠產品品質穩定且能符合客戶要求、加上市場對銅箔的需求持續暢旺，營運表現不俗

第一季與前期比較



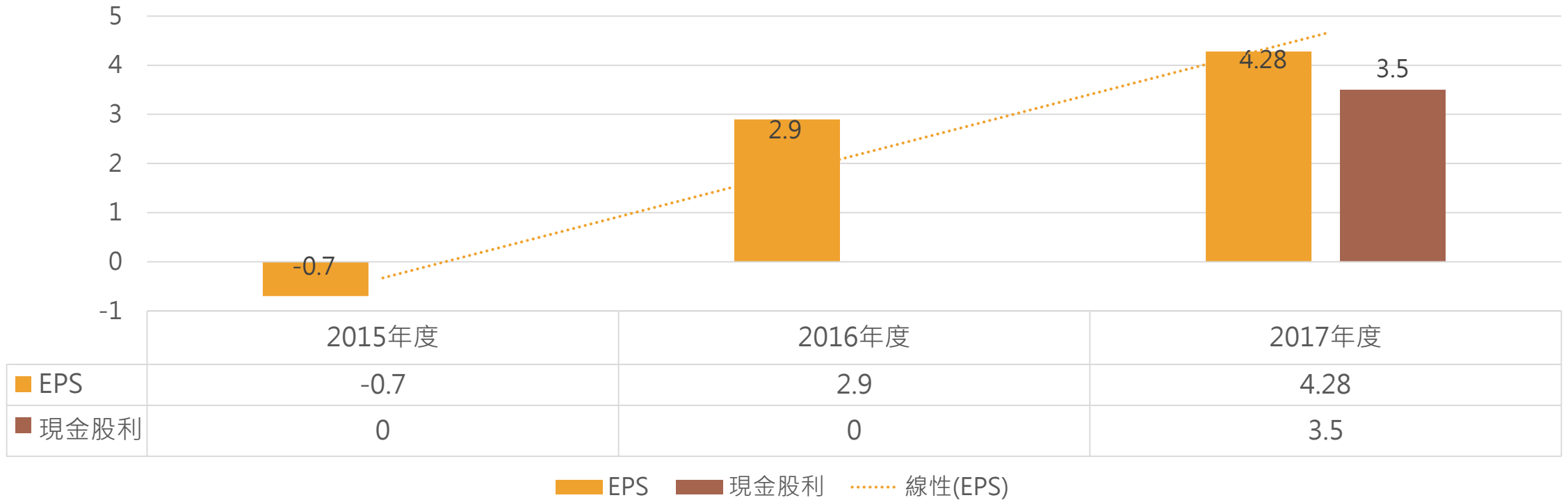
- 在市場供需持續調節下，本公司2018年第一季營運表現雖不及去年同期，但與上期相當

- 整體而言，產業回復健康狀態，毛利率及營業利益率尚能維持該有水準

# 經營實績

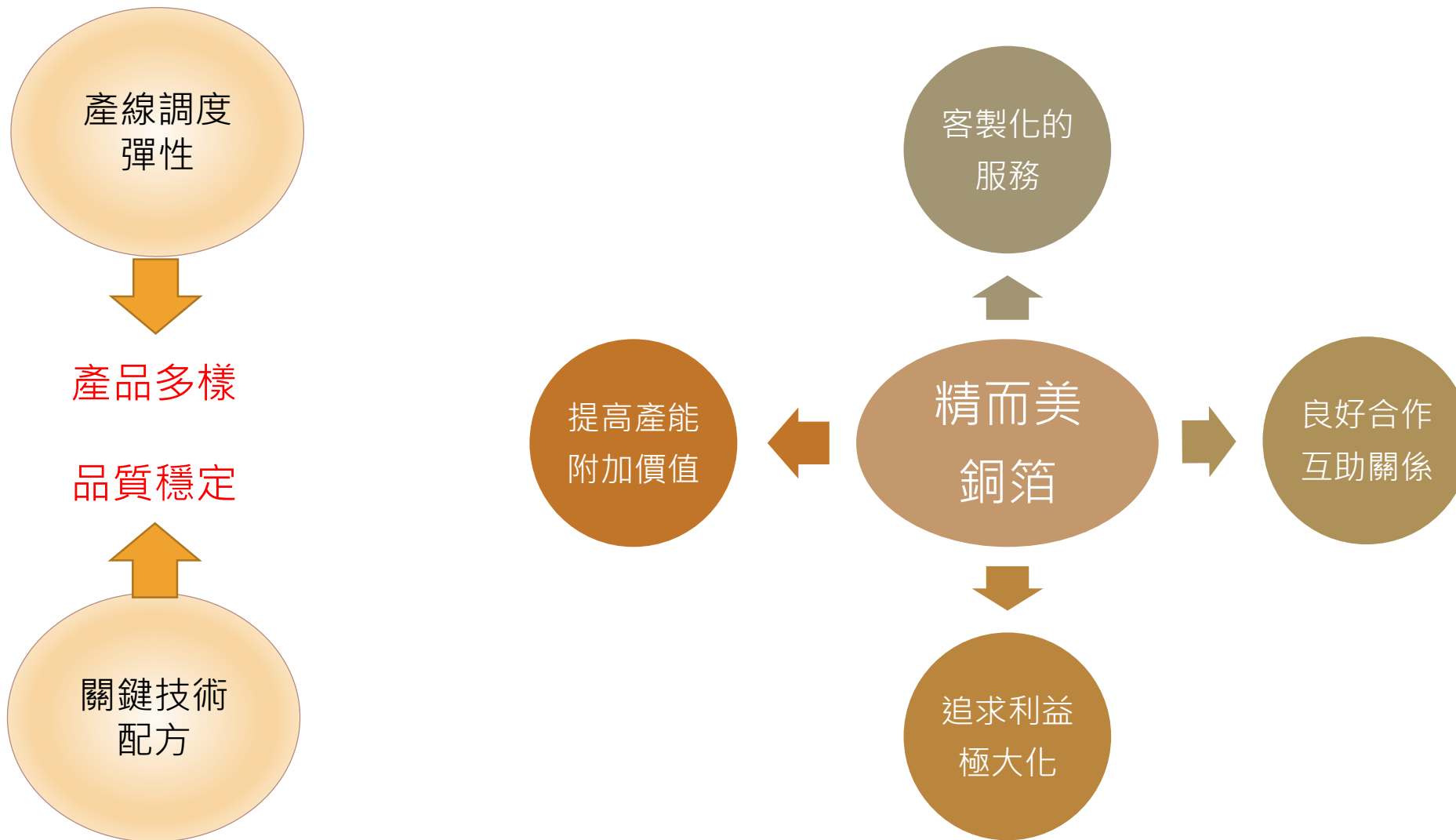
單位：新台幣元

## EPS 與現金股利



- 股利發放原則：配發率不低於6成
- 2017年度現金殖利率超過10%

# 競爭優勢



# 競爭利基

專業電解銅箔製造廠  
李長榮科技

掌握技術趨勢持續開發市場  
主流產品

- 超低稜線銅箔(Hyper-VLP)、超細緻的次微米瘤化技術
- 超低粗糙度產品DSS-LX系列、HTE-RT系列
- 鎖定在高速多層細線路板及高頻訊號傳輸板

良好且穩定的客戶關係

- 通過ISO 9001、TS16949國際品質認證
- 智慧型手機及車用電子等客戶之優良供應商認證
- 確實執行售前、過程及售後服務並安全準時交貨

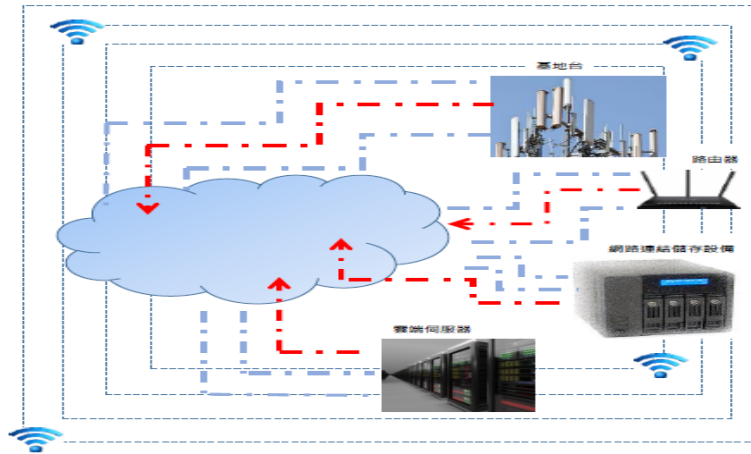
穩健的財務結構

- 健全資產負債結構
- 年度營業費用率(4%)低於同業(5-6%)
- 全產全銷，未來營運規劃決策執行之關鍵籌碼

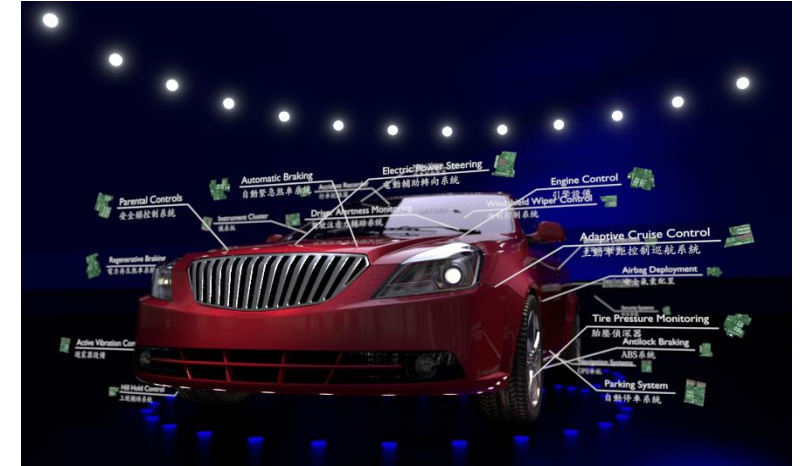
# 未來發展走向



消費性電子產品  
輕薄、多功能



高頻高速產品需求  
基地台、伺服器



車聯網應用  
防撞電達、安全系統



標準銅箔的需求提高

# 未來展望

01

## 長期客戶深耕

與客戶共同開發新用途並取得認證，並透過多元客製化產品提升對於全球客戶之滲透率。

03

## 穩定生產線及優質研發團隊

憑藉多年生產經驗，累積穩定的生產品質，加上優質研發團隊，產品獲客戶肯定，嚴格控管成本、兼具創新概念。

02

## 營運管理優化

透過產品結構之調整、優異的成本控管能力、自動化及節能生產管理，提升公司整體營運效率與盈利能力。

04

## 多元業務拓展

拓展各種不同領域的客戶群並優化客戶組合，例如PC、NB、LCD、HDI等開發高頻、高速材料以及類載板之技術及產品應用於運動休閒、汽車、航太及醫療等產業。



# 願景

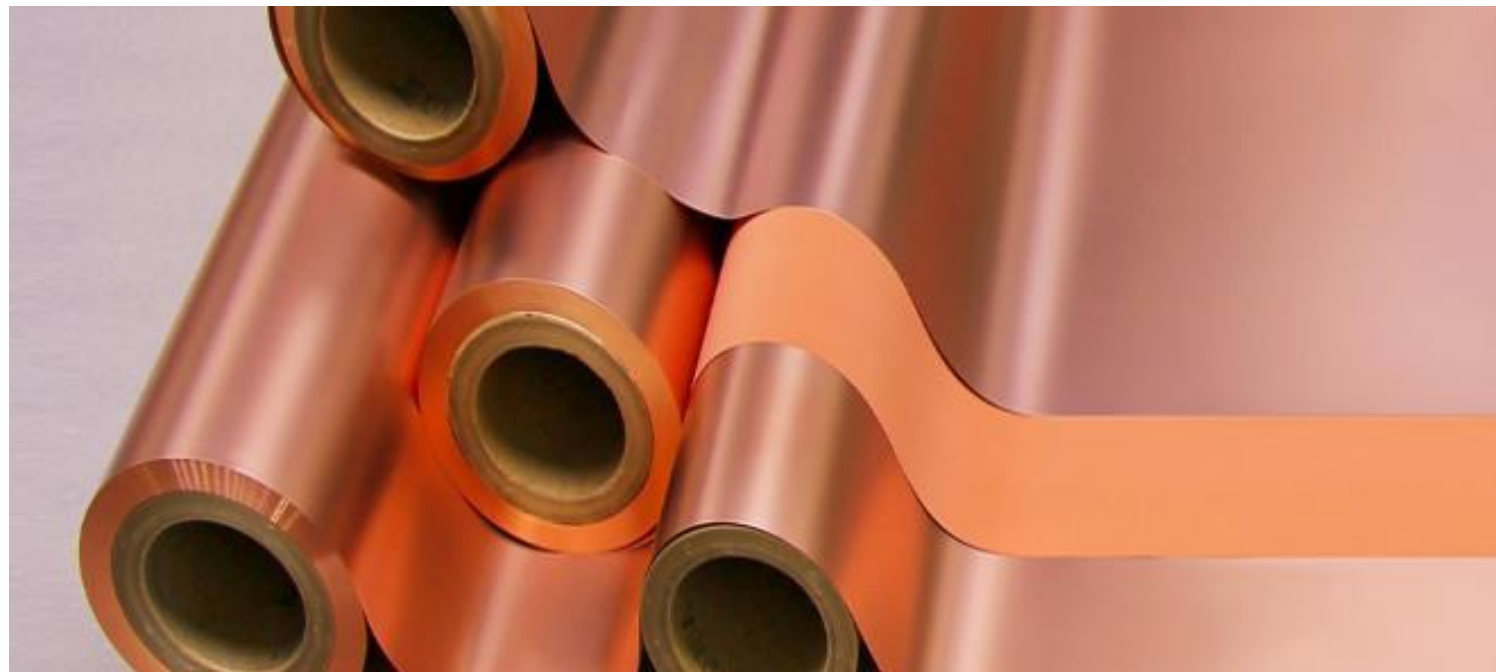


- 精緻工藝
- 追求卓越
- 創新經營



成為多樣性銅箔產品的標竿企業

## 附錄





# 董事會成員

職稱	姓名	持股比例(%)	學經歷	核心能力
董事長	李長榮化學工業股份有限公司	72.25	-	產業分析 營運管理 業務行銷
	代表人：王守仁		東海大學化學系學士 李長榮科技(股)公司總經理 李長榮化工(股)公司甲醇溶劑事業處副總經理	
董事	李長榮化學工業股份有限公司	72.25	-	產業分析 營運管理 業務行銷
	代表人：宋定邦		政治大學經營管理碩士(EMBA) 李長榮科技(股)公司副總經理 李長榮化工(股)公司高性能塑膠處副總經理	
董事	李長榮化學工業股份有限公司	72.25	-	財務金融 風險管理
	代表人：魏正誠		輔仁大學企業管理系學士 李長榮化工(股)公司財務中心資深副總經理、經營委員會委員、發言人	
董事	鍾宛真	-	美國賓州大學華頓商學院企管碩士 花旗銀行企業金融交易室資深副理	財務金融
獨立董事	劉三錡	-	東吳大學會計學系學士	財務會計
獨立董事	涂偉華	-	佛光大學管理學系講座教授兼副校長 成功大學會計統計學系學士	財務會計 營運管理
獨立董事	朱念慈	-	中央大學高階主管企管碩士(EMBA) 台灣杜邦(股)公司新創事業部副總經理	產業分析 營運管理

薪酬委員會成員  
審計委員會成員

# 企業社會責任

## 環境保護

- 尊重生命 恪遵法規
- 污染預防 持續改善
- ISO 14001認證
- 次級品銅回溶再利用
- 依規定處理事業廢棄物
- 全製程「無鉛、無砷」，符合RoHS、PoHS及REACH等國際規範

## 善待股東 及 員工

- 股利政策完善，並將電子投票列為股東行使表決權管道
- 依規定提撥員工退休金及辦理各項福利活動
- 營運地社區招募人力之落實(約50%)
- 近三年依物價水準調整員工薪資(2.5%~3%)



## 社會貢獻

- 太陽能政策響應
- 節電措施：ED電鍍槽內部FRP絕緣計劃、空調系統效率改善，2016年平均年節電率達2.25%
- 水資源利用
- 植栽綠化
- 社會救濟捐贈
- 參與基金會公益活動

## 公司治理

- 恪遵誠信經營守則，並訂有誠信經營作業程序及行為指南
- 審計委員會
- 薪資報酬委員會
- 重視利害關係人溝通
- 子公司監理制度
- 投保董事及經理人責任保險



**Thanks for your attention!**

**D**ifferentiation · **I**nnovation · **G**reen